

INVESTOR RELATIONS

2023년 1분기

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

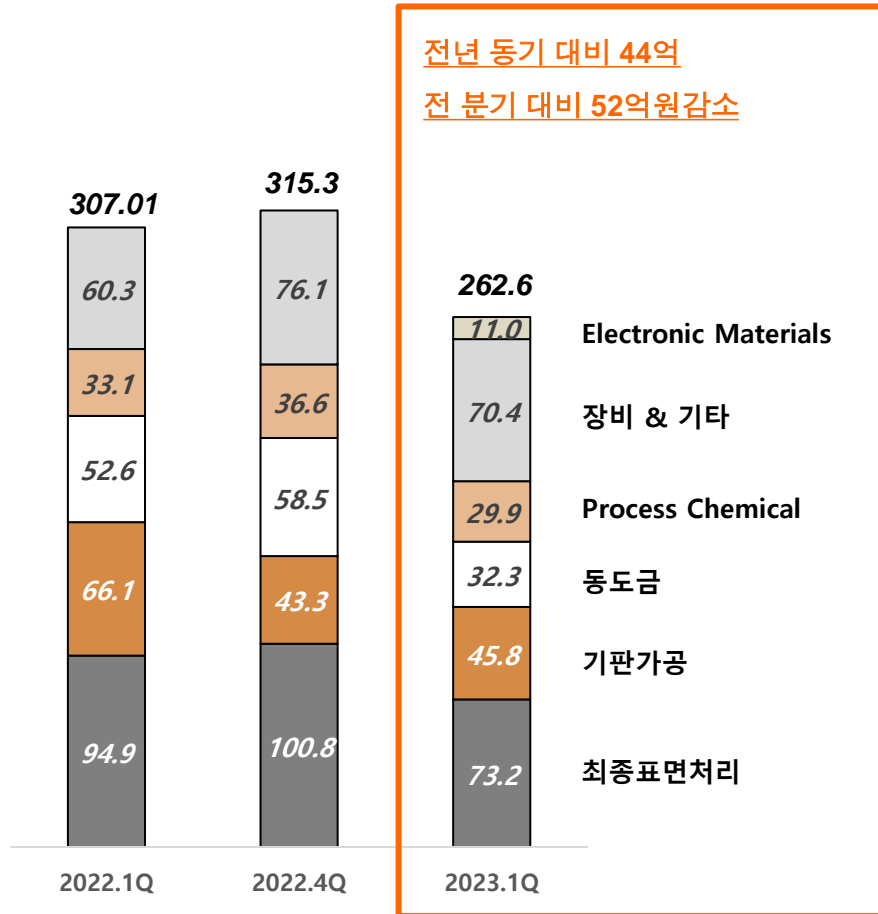
- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



Sales Result

■ 최종표면처리 ■ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process chemical ■ 장비&기타 ■ 동박



실적Review

• 1분기 FPCB 불황으로 인한 실적 감소

- ✓ 상저하고의 스마트폰 경기 특성으로 인한 매출 감소(북미고객사 생산시작인 2분기 말 반등)
- ✓ 특히, 경기침체로 S사 물량과 중화권 물량이 크게 감소하면서 해당 영역에 비중이 큰 기판가공과 동도금 물량 감소
- ✓ 당초 예상 대비, 고객사 설비 셋업 지연 이슈로 PKG 공급 침투가 늦어져 사업계획에 영향

Performance

• 23년 1분기 PKG 고객사향 매출 : 46.1억원 (매출대비 17.5%) 으로 전년 동기대비 + 7.7억, 전 분기 대비 +17.7억 으로 증가

- ✓ PKG 고객사향 동박 공급개시와 및 동도금, Process Chemical 제품의 매출증가로 어려운 영업상황 속 매출 신장

• 나노투스동박의 양산을 개시하여 전장 向 으로 공급증

- ✓ 23년 1분기 전자재료 사업부 매출 약 11억원
- ✓ 현재 물량 증가추세에 있으며 고객사 추가 시 매출확대

• 적극적인 해외고객사 영업으로 2분기 태국시장 진출

기존 Business Area 및 신규진입분야

- A** 기존 Chemical Business 사업영역 내 FPCB 에서 PKG 기판으로 당사 제품 적용분야 확대
- B** PCB 기초소재인 극동박 분야로 확장 (PKG 제조 시 사용되는 극동박)



- 당사 동박 적용을 확대할 고객사 승인 및 프로모션 중
- 1분기 대비 물량 확대중

Supplier of Advanced Electronic Materials

나노투스동박 영업 상황

- 현재 공급하고 있는 고객사 외 PCB 제조사 및 End-user에도 Promotion 중이며, 당사 기술에 대한 기술적 호평
- 다수 업체에 샘플 제공 중이며 적극적으로 피드백을 반영하여 제품 개선 등 시장활로 개척 중
- 7월 북미반도체쇼(Semicon -West)에 부스 참가 예정이며, 나노투스동박을 필두로 당사의 PKG 약품 홍보 예정

동박 라인 증설

- 동박라인 증설과 관련하여 기존 화성부지에 공장을 신축하는 방안에서 현 안산공장을 증설 방안으로 검토 중
- 경기침체 및 시장환경 악화로 과다채고 등의 악재가 발생하는 상황에서 공격적인 투자보다는 현 200억원 수준의 Capa를 500억원 수준으로 증설하는 방안을 고려
- 화성공장 신축 투자예상액은 0000억원으로 추산되나, 안산공장 증설의 경우 000억 절감한 0000억원으로 현금유동성 등 투자 Risk 감소 예상

해외 현지 생산

- 상반기 내 해외법인 생산시스템에 대한 검토와 기초 Process 셋업 예정
- 중국법인은 인프라 설비 확보가 완료된 상태로 하반기 시제품 및 양산품 생산이 목표
- 베트남법인의 경우 현지에서 수급가능한 원재료가 전무한 관계로 물류비 절감 폭 및 생산량이 많은 아이템을 선정하여 계획 중

송도 R&D 센터

- 6월내 착공식 개최 및 24년 말 완공 예정
- 건축비용과 관련하여, 보유 현금 및 향후 자금흐름을 반영/결정하였으며, 남동공단 부지 및 공장 일부를 매각 예정

Income Statement

(단위:억원)

	2023.1Q	매출비중	2022.1Q	매출비중
I. 매출액	262.6	100%	307.1	100%
II. 매출원가	218.6	83.2%	223.2	72.7%
III. 매출총이익	44.0	16.8%	83.9	27.3%
판매비와 관리비	63.0	24.0%	74.6	24.3%
IV. 영업이익	-19.0	-7.2%	9.3	3.0%
금융수익	15.2	5.8%	15.3	5.0%
금융비용	13.9	5.3%	11.9	3.9%
기타수익	9.7	3.7%	0.9	0.3%
기타비용	0.4	0.2%	1.4	0.4%
지분법손익	0.0	0.0%	0.0	0.0%
V. 법인세차감전순이익	-8.4	-3.2%	12.2	4.0%
법인세비용	6.4	2.4%	13.9	4.5%
VI. 당기순이익	-14.8	-5.6%	-1.7	-0.5%

주요 수익성 지표

	2023.1Q	2022.1Q
영업이익률	-7.2%	3.0%
순이익률	-5.6%	-0.5%
EBIT	1.7	27.0
EBITDA (마진율)	0.66%	8.80%
ROE	-1.6%	-0.6%
총자산회전률	10.5%	12.4%

Balance Sheet

(단위:억원)

	2023.1Q	2022.1Q
자산		
현금성자산	507.0	531.4
매출채권	203.4	222.1
재고자산	199.3	189.2
유형자산	1,122.1	1,103.5
기타자산	472.3	432.9
자산총계	2,504.1	2,479.1
부채		
매입채무	29.1	33.8
차입금	501.0	503.7
전환사채	93.8	89.9
기타부채	345.0	338.1
부채총계	968.9	965.5
자본		
자본금	81.6	81.6
자본잉여금	366.4	360.1
기타자본	67.6	45.8
이익잉여금	743.4	763.2
비지배지분	276.2	262.9
자본총계	1,535.2	1,513.6
부채와 자본총계	2,504.1	2,479.1

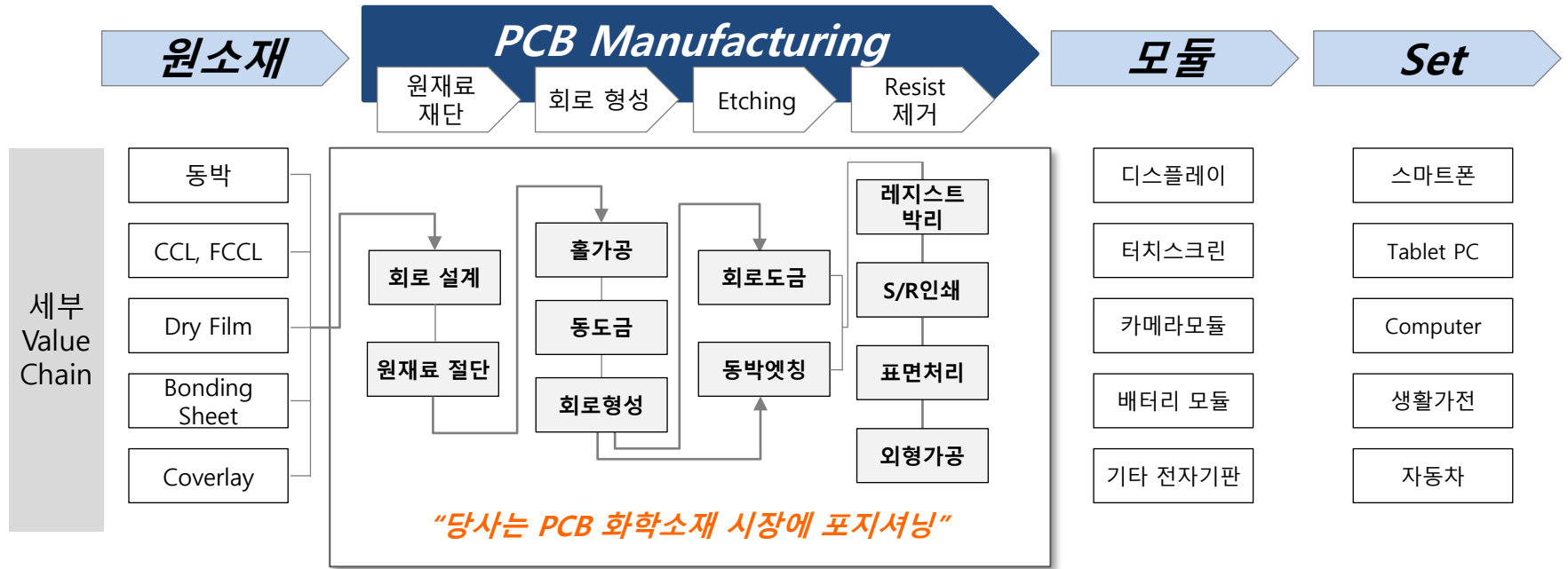
Cash Flow

(단위:억원)

	2023.1Q	2022.1Q
기초현금	531.4	701.9
영업활동으로 인한 현금흐름	15.0	39.0
당기순이익	(14.8)	(1.6)
감가상각비	20.7	17.8
주식보상비용	4.9	4.3
기타	4.2	18.5
투자활동으로 인한 현금흐름	(49.1)	(208.8)
유무형자산의 처분(취득)	(33.6)	(87.1)
금융상품의 감소(증가)	0.0	(28.5)
기타	(15.5)	(93.2)
재무활동으로 인한 현금흐름	(5.7)	(5.0)
차입금의 증가(감소)	(2.7)	(2.7)
리스부채의 상환	(2.7)	(2.0)
기타	(0.3)	(0.3)
현금증감	(39.8)	(174.8)
환율 변동효과	15.4	7.2
기말현금	507.0	534.3

PCB 사업부

PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대 중”
 End User 또한 기존 스마트폰 제조사에 한정되어 있었으나 전기차, 통신칩 등 첨단 산업으로 확대

FPCB Customer	   
	   
	   
PKG Substrate	    

Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정/박리제부터 최종표면처리까지, 모든 화학소재 기술을 보유함으로써 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



Final Finishing Chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

ENEPIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

EPIG process

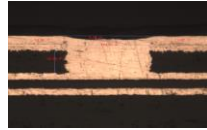
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

Immersion process

- ✓ PROTIN Series

Electrolytic gold process

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

Electrolytic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



Process Chemical

DES Chemical

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

Gold Recover

UBM Etchant

LAZ Process



New product for 5G

No etching and roughness laminating pretreatment

Ultra low profile detachable thin copper foil

Positive Cu roughening

Process Nanotus®

Electroless Copper plating for LCP

소재 사업부

Nanotus(나노투스) 극동박(Ultra thin copper foil)은 도금기술을 활용, 표면에 미세한 돌기를 형성하여 밀착력과 전송손실 모두를 만족하는 차세대 동박으로 End-User의 승인 완료후 현재 전장용 5G통신용 기판으로 양산, 공급중에 있음

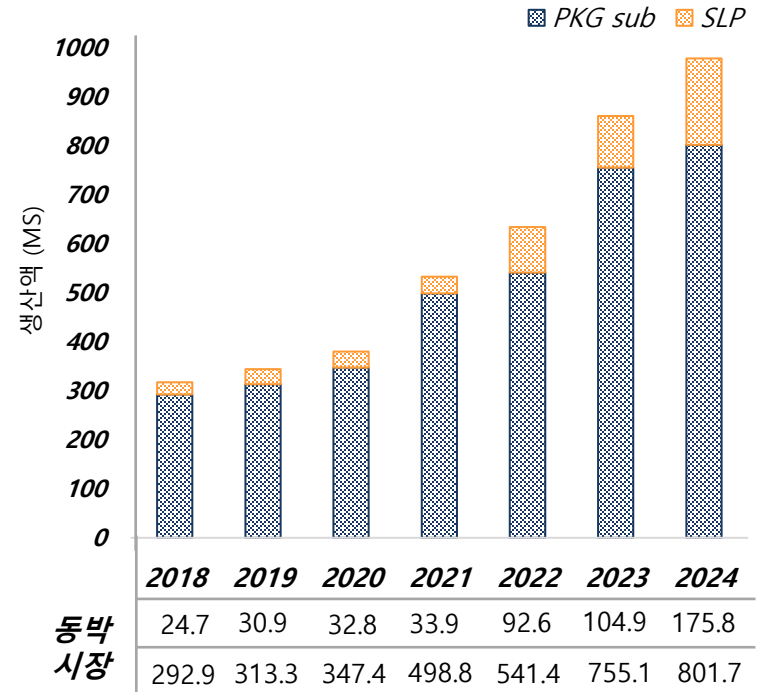
동박 시장의 분류

두께	용도	주요업체
1um~3um	<ul style="list-style-type: none"> PKG 기판의 원소재로 Msap 및 SAP 공법에 적용 	일본 미쓰이社(독점)
6um~8um	<ul style="list-style-type: none"> 전기차 음극재 PCB 	SK넥실리스(한국), 왓슨(중국), 창춘(대만), 일진머티리얼즈(한국)
10um~	<ul style="list-style-type: none"> 일반 PCB 	중국업체 중심 국내 일부 업체

Key factor

- 표면의 조도 (평탄도)
 - 조도가 클수록 밀착력은 상승하나 신호의 전송측면에서 불리
- 얇으면서도 균일한 두께의 동 표면
 - 회로형성과정에서 에칭하여 구리 표면이 사라지게 되는 균일하지 않은 표면을 에칭할 경우 과도한 약품 사용으로 회로가 손상
 - 이에 동박의 얇은 두께는 미세회로 구현의 필수 요소

PKG 기판 시장 자체의 성장과 제조방식인 Msap,SAP 공법 적용의 확대로 2024년 1조원대로 성장 전망



Nanotus® 동박의 기술적 포인트

- 현 공법은 절연필름을 에칭한 표면을 이용하여 밀착력 확보하기 때문에 Control이 어려워 표면이 일정치 않음 → 이에 미세회로 구현 시 불리
 - 별도의 에칭장비 또한 필요하며, 현 동박과 절연필름 공급부족 전망
- 절연필름을 에칭하지 않기 때문에 일정한 조도의 표면을 구현 미세회로 구현에 적합
 - 별도의 투자없이 공정 진행가능
 - 절연필름을 에칭하지 않기 절연필름의 손상이 없음. 이에 제품 구현시 이론상의 Spec을 그대로 발휘
 - 향후 현재 시장을 독점하고 있는 A社 외 제품의 사용이 가능할 것으로 전망

Nanotus®

Cu foil



Cu pattern → DF 박리 후



Seed etching



Seed etching 완료

Conventional



고조도

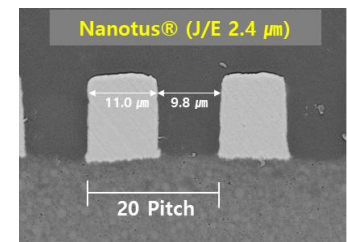
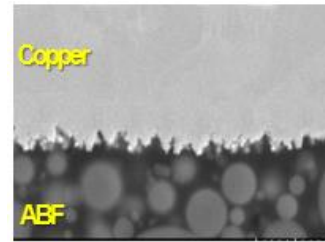


높은 조도로 인한 미 에칭 잔동 발생

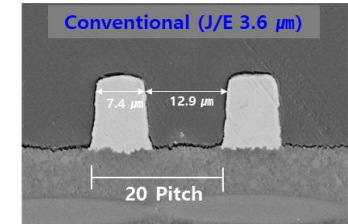
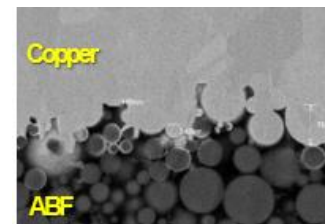


회로폭 감소, U/C risk

• 우수한 미세회로 구현 능력 Nanotus



• 기존 공법 : 비균일한 조도로 회로폭 손상



Phase I: 자원 재배치 및 신규시장 침투 ('22 ~ '23)

Phase II: 시장점유율 확대 ('24 ~ '25)

Phase III: 종합 부품소재 회사 ('26 ~)

Chemical Division	Business	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 PKG용 화학소재 매출 증대 <ul style="list-style-type: none"> F/RF-PCB → PKG 비중 확대 5G 관련 화학소재 개발 <ul style="list-style-type: none"> Ni-Less 표면처리약품 (Optimus), Nanotus 기술 적용 FPCB 생산기지 이전에 따른 인적, 물적 자원의 재배치 	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 PKG용 화학소재 매출 비중 확대 <ul style="list-style-type: none"> F/RF-PCB 매출 < PKG 매출 5G용 화학소재 본격화 <ul style="list-style-type: none"> 고객사 승인 완료 후 본격 양산 중국 시장 매출 본격화 자동차, 항공 등 고부가 시장 진출 	<ul style="list-style-type: none"> Wafer 동도금 화학소재 진출 <ul style="list-style-type: none"> 반도체 관련 시장 확대 6G용 화학소재 개발 <ul style="list-style-type: none"> 고객사 협력을 통한 선행 개발 후 본격 사업화
	Capex	<ul style="list-style-type: none"> 중국 주해 공장 가동 <ul style="list-style-type: none"> 23년 상반기 셋업 목표 베트남 공장 약품 생산 시작 	<ul style="list-style-type: none"> PKG 약품 공급을 위한 국내 약품제조 시설 업그레이드 주해 공장 가동률 향상 (약품, 외주) 	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 약품 제조 공장 증설 북미 고객사를 위한 해외공장 증설

신규 Business

Materials Division	Business	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 양산 스타트 및 고객사 수 확대 <ul style="list-style-type: none"> PKG 제조사 및 End User 영업강화 양산 효율화 <ul style="list-style-type: none"> 외주공정 내재화 비용 효율화 디스플레이 분야 신규 아이템 사업화 	<ul style="list-style-type: none"> 극동박 본격적 매출 확대 <ul style="list-style-type: none"> 기술우위를 통한 5G 시장 공략 외형확대를 통한 이익률 상승 동박의 연계 Application 시장 침투 <ul style="list-style-type: none"> 저유전 소재, 차폐 소재 등 디스플레이 신규 아이템 양산 	<ul style="list-style-type: none"> 극동박 해외 시장 매출 확대 <ul style="list-style-type: none"> Global Set, Chip 회사들과의 협업 동박을 활용한 다양한 모듈 및 부품의 생산 안정화 및 매출 확대
	Capex	<ul style="list-style-type: none"> 현 공장 양산효율화 <ul style="list-style-type: none"> '22년 세팅, '23년 안정화 동박 신규공장 증설 	<ul style="list-style-type: none"> 동박 신규공장 안정화 및 가동률 상승 <ul style="list-style-type: none"> 국내 신규공장 가동 시작 및 매출확대 Application 생산을 위한 공잔 건설 	<ul style="list-style-type: none"> 모듈 제작을 위한 공장 증설 해외공장 가동 및 안정화



감사합니다

Thank you